

## 12. Berliner Technologieforum



Aktuelle Trends in der Elektronikfertigung - new ways to go

Während unsere Gesellschaft und Industrie kontinuierlich mit neuen Herausforderungen wie Verfügbarkeit der Rohstoffe und Bauelemente, Logistik oder CO<sub>2</sub>-Reduktion konfrontiert wird, schreitet die Umsetzung der Innovationen in den Bereichen der Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronikfertigung stetig voran.

Basierend auf der Teilnehmerumfrage des letzten Technologieforums haben die Veranstalter aus einer Vielzahl von Vorschlägen die Topthemen ausgesucht. Lassen Sie sich durch diese praxisrelevanten Vorträge inspirieren und Antworten auf aktuelle Fragen finden.

Das 12. Berliner Technologieforum stellt sowohl den Erfahrungsaustausch zu bereits gewonnenen Erkenntnissen als auch einen kurzen Ausblick auf die zukünftigen Trends der Elektronikfertigung in den Mittelpunkt.

Die Partnerfirmen Siemens, Rehm Thermal Systems, ASM Assembly Systems, ASYS Group, ATEcare, Balver Zinn, Christian Koenen, kolb Cleaning Technology, MTM Ruhrzinn, Vliesstoff Kasper und Zevac laden Sie

herzlich zum

## **12. Berliner Technologieforum**

am **2. Juni 2022** ein.

Diskutieren Sie mit den Experten neueste Trends und spannende Technologien.

**Sprache:** Deutsch

**Teilnahmegebühr:** Kostenfreie Veranstaltung

**Für eine Teilnahme senden Sie einfach eine E-Mail unter Nennung aller Teilnehmer und deren E-Mail-Adressen an**

- Fr. Annika Erhard, [a.erhard@rehm-group.com](mailto:a.erhard@rehm-group.com)

**Beginn:**

Donnerstag, 2. Juni 2022, 08:00 Uhr

**Ende:**

Donnerstag, 2. Juni 2022, 16:15 Uhr

**Veranstaltungsort:**

Berlin

Deutschland

**Website & Anmeldung:**

<https://www.rehm-group.com/aktuelles/termine/detail/11-berliner-technologieforum-1-1.html>